



Halogen-free

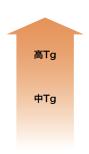
Laminate

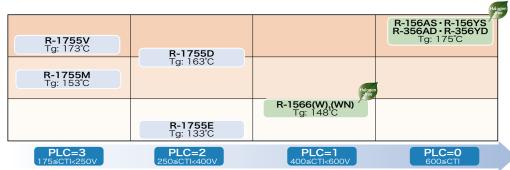
R-356AD R-356YD **Prepreg** R-355AD R-355YD

高耐熱ハロゲンフリー多層基板材料

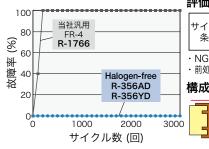
xEVや産業機器デバイスで要求される高耐熱・高耐電圧に対応 高いトラッキング性で基板サイズ・モジュールの小型化に貢献 環境への負荷を考慮したハロゲンフリー材料

製品 ラインアップ





スルーホール導通信頼性



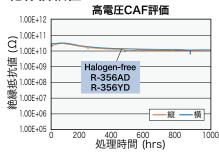
評価条件



構成



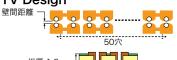
絶縁信頼性

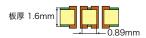


評価条件

前処理	260°Cピークリフロー×3回
条件	85°C, 85%RH, DC 1000V
スルーホール壁間距離	0.89mm

TV Design





·般特性

項目		試験方法	条件	単位	Halogen-free R-356AD	Halogen-free R-356YD	当社一般ハロゲンフリー R-1566(W)
ガラス転移温度(Tg)		DSC	- A	°C	175		148
		TMA			170		145
熱分解温度(Td)		TGA	А	°C	355		350
T288(銅付)		IPC-TM-650 2.4.24.1	А	分	10		3
熱膨張係数(厚さ方向)	α1/α2	IPC-TM-650 2.4.24	А	ppm/°C	40 / 180		40 / 180
RTI / PLC		UL Method	C-48/23/50	1	150*1 / 0*3	150*2 / 0	130 / 1
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	А	kN/m	1.6		1.8
耐燃性		UL Method	C-48/23/50	_	94V-0*3	94V-1	94V-0

試験片の厚さは0.8mmです。

※1 板厚0.8mm於いて ※2 板厚0.63mm以上 ※3 板厚0.8mm以下

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。